

Dickschichtmetallisierung: Ag - Polymer

Substrat	ANCeram Aluminiumnitrid
Oberflächenqualität	$R_a < 1,0 \mu\text{m}$
Metallisierung	Silberpolymerpaste
Geometrie	nach Kundenwunsch
min. Leiterbahnabstand	200 μm
min. Leiterbahnbreite	200 μm
Flächenwiderstand	$60 \pm 10 \text{ m}\Omega / \square$
Lötempfehlung	Bedingt lötfar mit PbSn-Loten
Haftfestigkeit	$> 5 \text{ N/mm}^2$
Abdeckung	Mit Lötstopplack

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand.
Änderungen, bedingt durch Produktverbesserungen und Weiterentwicklungen sind möglich.
Kundenspezifische Anpassungen und Ausführungen sind auf Wunsch machbar.

Stand 06/99

